

半导体缺陷检测，驱动器老化测试

产品名称	半导体缺陷检测，驱动器老化测试
公司名称	无锡万博检测科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	
公司地址	无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼
联系电话	13083509927 18115771803

产品详情

半导体缺陷检测，驱动器老化测试

塑料四边引脚扁平封装PQFP

塑料四边引脚扁平封装PQFP

芯片的四周均有引脚，其引脚数一般都在100以上，而且引脚之间距离很小，管脚也很细，一般大规模或超大规模集成电路采用这种封装形式。用这种形式封装的芯片，必须采用表面安装设备技术(SMT)将芯片边上的引脚与主板焊接起来。PQFP封装适用于SMT表面安装技术在PCB上安装布线，适合高频使用，它具有操作方便、可靠性高、芯片面积与封装面积比值较小等优点。

带引脚的塑料芯片载体PLCC。它与LCC相似，只是引脚从封装的四个侧面引出，呈丁字形，是塑料制品。引脚中心距1.27mm，引脚数从18到84。J形引脚不易变形，比QFP容易操作，但焊接后的外观检查较为困难。它与LCC封装的区别仅在于前者用塑料，后者用陶瓷，但现在已经出现用陶瓷制作的J形引脚封装和用塑料制作的无引脚封装。

无引脚芯片载体LCC或四侧无引脚扁平封装QFN。指陶瓷基板的四个侧面只有电极接触而无引脚的表面贴装型封装。由于无引脚，贴装占有面积比QFP小，高度比QFP低，它是高速和高频IC用封装。但是，当印刷基板与封装之间产生应力时，在电极接触处就不能得到缓解，因此电极触点难于做到QFP的引脚那样多，一般从14到100左右。材料有陶瓷和塑料两种，当有LCC标记时基本上都是陶瓷QFN，塑料QFN是以玻璃环氧树脂为基板基材的一种低成本封装。

球型矩阵封装BGA

BGA封装经过十几年的发展已经进入实用化阶段，目前已成为热门的封装。

随着集成电路技术的发展，对集成电路的封装要求越来越严格。这是因为封装关系到产品的性能，当IC的频率超过100MHz时，传统封装方式可能会产生所谓的交调噪声"Cross-Talk Noise"现象，而且当IC的管脚数大于208脚时，传统的封装方式有其难度。因此，除使用QFP封装方式外，现今大多数的高脚数芯片

皆转而使用BGA封装。BGA一出现便成为CPU、高引脚数封装的佳选择。BGA封装的器件绝大多数用于手机、网络及通信设备、数码相机、微机、笔记本电脑、PAD和各类平板显示器等消费市场。